PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-111170

(43)Date of publication of application: 12.04.2002

(51)Int.CI.

H05K 1/18 B23K 1/00

(21)Application number: 2000-298269

(71)Applicant: MITSUMI ELECTRIC CO LTD

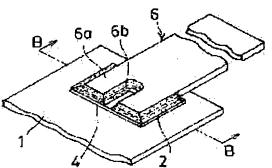
(22)Date of filing:

29.09.2000

(72)Inventor: TAKEDA ITARU

(54) MOUNTING MECHANISM OF METALLIC PLATE IN PRINTED WIRING BOARD (57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To improve strength in fixing of a metallic plate that is mounted on a land provided in a printed wiring board. SOLUTION: A printed wiring board is assembled in a portable telephone and the like. The printed wiring board 1 has a land 2, and a metallic plate made of nickel plate 6 or the like is connected with terminal part of a battery and the like through solder in the mounting structure of the metallic plate in the printed wiring board. A joint part 6a of the nickel plate joined with the land 2 has an opening 6b so that the total length of a solder fillet 4 of solder formed by the opening 6b between the land 2 and the joint part 6a can be increased in the mounting structure of the metallic plate in the printed circuit board.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-111170 (P2002-111170A)

(43)公開日 平成14年4月12日(2002.4.12)

(51) Int.Cl.7		識別記号	F I	テーマコート*(参考)
H05K	1/18		H05K 1/18	U 5E336
B 2 3 K	1/00	330	B 2 3 K 1/00	3 3 0 D

審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全 4 頁)

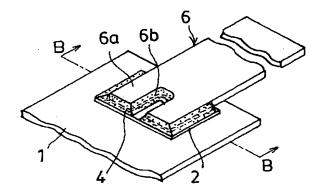
(21)出願番号	特願2000-298269(P2000-298269)	(71) 出願人 000006220	
(oo) disserted	Wichight a Hoard (ease a sa)	ミツミ電機株式会社	
(22)出顧日	平成12年9月29日(2000.9.29)	東京都調布市国領町8丁目8番地2	
		(72)発明者 武田 格	
		秋田県南秋田郡飯田川町飯塚字上堤敷95番	
		地2 秋田ミツミ株式会社内	
		(74)代理人 100060575	
		弁理士 林 孝吉	
		Fターム(参考) 5E336 AA04 BB01 CC32 DD03 EE03	
		GG06 GG16	

(54) 【発明の名称】 ブリント基板に於ける金属板の取付機構

(57)【要約】

【課題】 プリント基板に配設されたランドに取り付けられる金属板の取付強度を向上させる。

【解決手段】 本発明は、携帯電話等に組み込まれるブリント基板1であって、該プリント基板1にはランド2が配設され、該ランド2には電池等の端子部が接続されるニッケル板6等から成る金属板がはんだを介して接合されるブリント基板に於ける金属板の取付機構に於て、前記ランド2に接合される前記ニッケル板6の接合部6aに開口6bを設け、該開口6bにより前記ランドと前記接合部6aとの間に形成される前記はんだによるフィレット4の総延長を伸長するようにしたことを特徴とするプリント基板に於ける金属板の取付機構を提供する。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 ランドに電池等の端子部が接続される金 属板がはんだを介して接合されるプリント基板に於ける 金属板の取付機構に於て、前記ランドに接合される前記 金属板の接合部に切除部を設け、該切除部により前記ラ ンドと前記接合部との間に形成される前記はんだによる フィレットの総延長を伸長するようにしたことを特徴と するプリント基板に於ける金属板の取付機構。

【請求項2】前記金属板に設けた切除部は、該金属板の 上記接合部の前端部位に前面開放の口字状に形成された 10 ことを特徴とする請求項1記載のプリント基板に於ける 金属板の取付機構。

【請求項3】 前記金属板に設けた切除部は、該金属板 の上記接合部の両側に凹部が対峙して形成されて成ると とを特徴とする請求項1記載のプリント基板に於ける金 属板の取付機構。

【請求項4】 前記金属板に設けた切除部は、該金属板 の上記接合部の中間部に孔を設けて成ることを特徴とす る請求項1記載のプリント基板に於ける金属板の取付機 構。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】との発明は、ブリント基板に 於ける金属板の取付機構に関するものであり、特に、ラ ンドにはんだ付けされる金属板の取付強度を向上させた プリント基板に於ける金属板の取付機構に関するもので ある。

[0002]

【従来の技術】従来の此種プリント基板に於ける金属板 の取付機構の一例を図4及び図5に従って説明する。 【0003】図に於て1はプリント基板であり、該プリ ント基板1の表面に銅箔(以下、ランドという)2が配 設されており、該ランド2の上面に該ランド2と比べて 幅が狭い帯板状のニッケル板3の接合部3 a が重ねら れ、該ニッケル板3が該ランド2にリフローによっては んだ付けされている。

【0004】而して、該ランド2の前端は、前記ニッケ ル板3の接合部3aの前端から僅かに突出しており、従 って、該接合部3aの三辺と該ランド2の表面間には、 図5に示すように前記リフローによるはんだ付けの際、 溶融し流出したはんだによって断面略三角形のフィレッ ト4が形成されている。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】上記従来例のプリント 基板に於ける金属板の取付機構は、例えば、携帯電話等 に組み込まれるとき、小形軽量化のみならず、携帯に耐 えるはんだ付け強度(剥離強度)が要請される。

【0006】然し乍ら、上記プリント基板に於ける金属 板の取付機構は、前記小形軽量化の要請によって前記ラ ンド2の面積も小形となり、従って、前記ニッケル板3 の接合部3aの接合面積も狭隘とならざるを得ない。斯 くして、該ランド2とニッケル板3との接合強度も低下 する。

【0007】そとで、ランドの外形を増やすことなく、 金属板の取付強度を強化可能なブリント基板に於ける金 属板の取付機構を得るために解決すべき技術的課題が生 じてくるのであり、本発明はこの課題を解決することを 目的とする。

[0008]

【課題を解決するための手段】との発明は上記課題を解 決するために提案されたものであり、ランドに電池等の 端子部が接続される金属板がはんだを介して接合される プリント基板に於ける金属板の取付機構に於て、前記ラ ンドに接合される前記金属板の接合部に切除部を設け、 該切除部により前記ランドと前記接合部との間に形成さ れる前記はんだによるフィレットの総延長を伸長するよ うにしたプリント基板に於ける金属板の取付機構、及 び、前記金属板に設けた切除部は、該金属板の上記接合 部の前端部位に前面開放の口字状に形成されたプリント 20 基板に於ける金属板の取付機構、及び、前記金属板に設 けた切除部は、該金属板の上記接合部の両側に凹部が対 峙して形成されて成るプリント基板に於ける金属板の取 付機構、並びに、前記金属板に設けた切除部は、該金属 板の上記接合部の中間部に孔を設けて成るブリント基板 に於ける金属板の取付機構を提供するものである。

[0009]

【発明の実施の形態】以下、本発明の一実施の形態を図 1乃至図3に従って詳述する。先ず、請求項1及び請求 項2記載の発明を図1及び図2に従って説明する。尚、 30 従来例と同一部分には同一符号を付して説明を省略する ものとする。

【0010】図に於て、ニッケル板6にはプリント基板 1に配設されているランド2との接合部6aの中央端部 に、前面を開放した略口字状の開口6 bが開穿されてい る。即ち、該開口6 b によって該接合部6 a の平面形状 は略凹字状をなし、該開口6 b によって前記接合部6 a は左右にも分割されることになる。

【0011】而して、前記接合部6aの外周及び前記開 口6 bの内周と前記ランド2の表面との間には、図2 に 40 示すように該ランド2の表面に施された前記はんだの溶 融後の流出によって付着し硬化した断面略三角形のフィ レット4が形成される。従って、該ニッケル板6の接合 部6aに形成される該フィレット4は前記開口6bの内 周にも形成されるので、その分だけフィレット4の形成 部の総延長が大幅に伸長することになる。斯くして、該 ニッケル板6のランド2に対する取付強度(剥離強度) が向上する。

【0012】次に、請求項3記載の発明を図3(a)に 従って説明する。図に於て、ニッケル板7には基板1に 50 配設されたランド2との接合部7aの両側に半円状の凹

部7b.7bが対峙して形成されており、該凹部7b, 7 b によって形成された弧状の端面と前記ランド2の表 面との間にも、リフローによるはんだ付け工程によって フィレット4が断面略三角形に形成される。

【0013】従って、該ニッケル板7の接合部7aは、 外周の三辺に形成されるフィレット4のみならず、該凹 部7b.7bの端面と前記ランド2の表面間に形成され た前記フィレット4によって、前記ランド2と該ニッケ ル板7の接合部7aとの間に形成されるフィレット4の 板7のランド2に対する取付強度(剥離強度)が向上す る。

【0014】尚、この実施の形態では凹部7b, 7bの 形状を半円形とした例で説明したがこれに限定されるべ きでなく、ランド2及び接合部7aの平面形状に応じて 半楕円形状に形成してもよい。

【0015】次に、請求項4記載の発明を図3(b)に 従って説明する。図に於て、ニッケル板8には、基板1 に配設されたランド2との接合部8 a の中央部に略円形 の孔8 b が開穿されており、該孔8 b の内側面と前記ラ ンド2の表面との間にも前述のフィレット4が形成され

【0016】従って、該ニッケル板8の接合部8aは該 接合部8aの外周の三辺に形成されるフィレット4のみ ならず、該孔8 bの内側面と該ランド2の表面との間に 形成される該フィレット4によって前記ランド2との間 に形成されるフィレット4の全長を伸長させることが可 能となるので、該ニッケル板8の該ランド2に対する取 付強度(剥離強度)を向上させることが可能となる。

【0017】尚、該実施の形態に於て、前記孔8 b は打 30 ち抜き加工によって形成されるを可とする。然るときは 該孔8bの加工が簡便となる。又、該孔8bは円形に限 定されるべきでなく、楕円形に形成しても同一の作用効 果を奏する。

【0018】又、上記実施の形態に於ては、ランド2に はんだ付けされる金属板の材料はニッケルの場合で説明* * したが、これに限定されるべきでなく、例えばニッケル めっきされた金属板でもよく、他の材料、例えば銅又は 銅合金であってもよい。

【0019】尚、本発明は、本発明の精神を逸脱しない 限り種々の改変を為すことができ、そして、本発明が該 改変されたものに及ぶことは当然である。

[0020]

【発明の効果】本発明は、上記一実施の形態にて詳述し たように、ブリント基板のランドにはんだを介して接合 総延長を伸長させることが可能となるので、該ニッケル 10 する金属板の接合部に切除部を設け、該切除部により該 金属板を該ランドにはんだ付けするとき、該ランドと前 記接合部との間に形成されるフィレットの総延長を伸長 するようにしたので、ランドの外形を増やすことなく金 属板の該ランドに対する取付強度を強化することができ ると共に、プリント基板の小形化及びコストダウンにも 寄与する等、正に著大なる効果を奏する発明である。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施の形態を示し、金属板の取付機 構の一部切欠斜視図。

【図2】図1のB-B線断面拡大図。

【図3】(a)本発明の他の実施の形態を示し、金属板 の取付機構の一部切欠斜視図。

(b) 本発明の更に他の実施の形態を示し、金属板の取 付機構の一部切欠斜視図。

【図4】従来例を示し、金属板の取付機構を示す―部切 欠斜視図。

【図5】図4のA-A線断面拡大図。

【符号の説明】

プリント基板

2 ランド

フィレット

6, 7, 8 ニッケル板

6a, 7a, 8a 接合部

6 b 開口

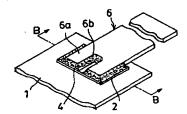
凹部 7 h

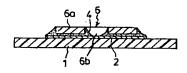
8 b ŦL.

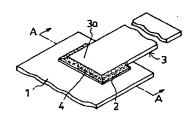
【図1】

【図2】

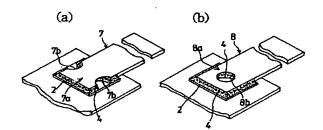
【図4】







【図3】



【図5】